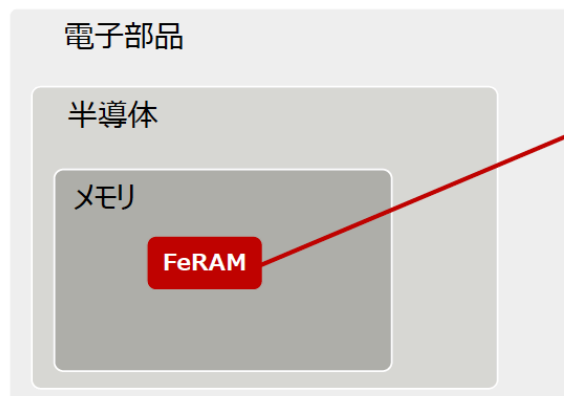


FUJITSU 富士通セミコンダクターメモリソリューション

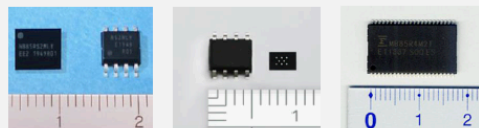
FeRAM(エフィーラム)とは?

FeRAMは、「Ferroelectric Random Access Memory」の略で、データを記憶する材料に強誘電体を使用した不揮発性メモリです。ROMとRAMの両方の性質を併せ持ち、高速書込み・高書換え耐性(多書換え回数保証)・低消費電力の特長があります。FeRAMの詳細な説明については、当社 FeRAMウェブサイトをご覧ください。

- FeRAMは、半導体の「メモリ」のひとつです。
- Ferroelectric RAMの略称です。
- 強誘電体メモリとも呼ばれます。



FeRAMの実物写真



FeRAMのパッケージ



2022年度上期(4月~9月)各社業績

一般電子部品	売上高 前年同期比	売上高	営業利益 前年同期比	営業利益	
TDK	26%↑	1.1兆円	47%↑	1203億円	過去最高を更新
アルプスアルパイン	24%↑	4543億円	89%↑	199億円	過去最高を更新
日本航空電工業	9%↑	1222億円	17%↑	108億円	増収増益
村田製作所	1%↑	9202億円	12%↓	1950億円	
製造装置・部材関連	売上高 前年同期比	売上高	営業利益 前年同期比	営業利益	
京セラ	16%↑	1兆122億円	1%↑	765億円	過去最高
ファナック	18%↑	4161億円	0.8%↑	947億円	
SCREEN	25%↑	1765億円	58%↑	383億円	
オムロン	10%↑	4044億円	9%↓	416億円	増収減益
液晶・ディスプレイ	売上高 前年同期比	売上高	営業利益 前年同期比	営業利益	
シャープ	7%↓	406億円	65%↓	123億円	
日本電子硝子	16%↑	2512億円	6%↓	232億円	
自動車産業・部品	売上高 前年同期比	売上高	営業利益 前年同期比	営業利益	
デンソー	17%↑	3兆301億円	3%↓	1554億円	売上過去最高

傾向

PC向けはダウンサイクルに入りつつある。但し24年以降緩やかに回復に転じていく。スマホ販売は低迷。中低位機種が振るわず。円安がプラス要因とマイナス要因になる企業に明暗が分かれた。設備投資は部材の納期遅れで23年度にズレ込む為下方修正している。IT機器需要の一巡により加工機マシンが減収。上海ロックダウン、部材や物量費の高騰によるマイナス影響。

村田:自動車、基地局、ウェアラブル増収。PC、スマホが減収。

TDK:EV車、産業機器向けで増収。

原材料確保の意味合いで若干手持ち在庫は増えているが、完成品在庫は多くない。今後はハイエンドスマホ向け需要が季節的に高まるほか、産業機器向けに堅調に推移する見通し。

トピックス

政府は、経済再生実現の為、次世代分野に約3兆円を投じる。この支援により9兆円以上の生産誘発効果を生み出し、2兆円以上の輸出増効果、

49万人の雇用者増をもたらす次世代大型投資を誘導する。半導体分野に1兆3000億円を充て、特定半導体の生産施設整備に6170億円の助成金を交付する事業を推進。半導体に関する支援を強化。